나노코리아 2024 산업화세션 개요

□ 나노코리아 2024 산업화세션 개요

- ○ 행사명 : 나노코리아 2024 산업화세션
- ○ 일 시 : 2024년 7월 4일(목) 13:00~16:50
- ○ 장 소 : KINTEX 제1전시장 강연장A
- ○ **주 제 : 차세대 반도체/디스플레이 산업 초격차 달성을 위한 나노융합기술**
- ○ 등록비용 : (일반) 150,000원 / (학생) 50,000원
- ○ 세부 프로그램

시간	발표주제	연사
1부 좌장 : 나종주 단장 (한국연구재단)		
(1부) 반도체 첨단 패키징		
12:50~ 13:00	개회사 : 전시위원장, 심포지엄위원장	
13:00~ 13:30	Technology and Future of Semiconductor Packaging Materials	문기일 부사장 (SK하이닉스)
13:30~ 14:00	Advanced Packaging Technology for AI Era	강운병 마스터 (삼성전자)
14:00~ 14:20	The advanced packaging technology in AI era ; Chiplet and Integration	김종헌 부사장 (네패스)
14:20~ 14:40	차세대 전력반도체 패키지용 200W/mK급 무가압형 칩본딩재 기술	김윤진 대표 (테라온)
14:40~ 15:00	반도체 접합용 무세척 에폭시 소재	문종태 대표 (호전에이블)
15:00~ 15:10	BREAK TIME	
2부 좌장 : 최경호 탄소나노PD (한국산업기술기획평가원)		
(2부) 차세대 디스플레이와 나노		
15:10~ 15:40	The Best Display Solution for SDV	손기환 상무 (LG디스플레이)
15:40~ 16:10	Challenge for next era of display	허종무 상무 (삼성디스플레이)
16:10~ 16:30	Perovskite Emitters for Next-Generation Displays	이태우 교수 (서울대학교)
16:30~ 16:50	융복합 폼팩터 디스플레이를 위한 고신뢰성 플렉시블 모듈 기술	정용철 선임연구원 (한국생산기술연구원)